

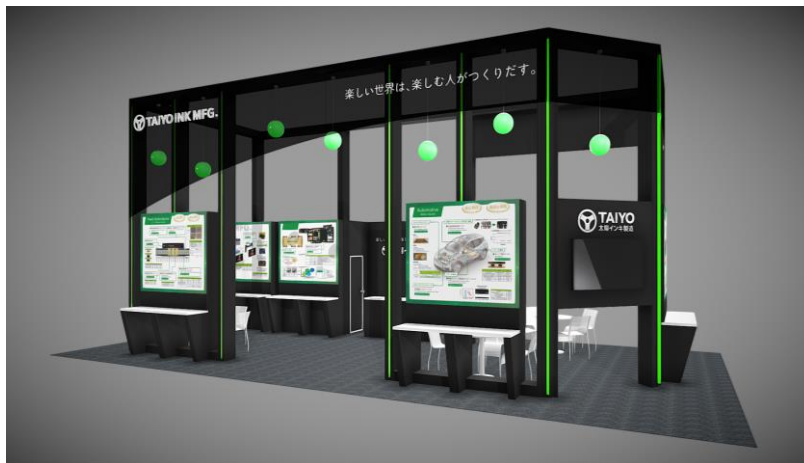
各位

2024年6月5日  
太陽ホールディングス株式会社

## 【太陽インキ製造】電子機器トータルソリューション展 「JPCA Show 2024」出展のお知らせ ～パワー半導体向け材料が第20回JPCA賞（アワード）受賞～

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：佐藤 英志、証券コード：4626）の子会社である太陽インキ製造株式会社（本社：埼玉県比企郡嵐山町、代表取締役社長：峰岸 昌司）は、2024年6月12日（水）～14日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される、電子機器トータルソリューション展「JPCA Show 2024」第53回国際電子回路産業展に出展します。

ブース内では、「自動車向け製品」、「パワー半導体向け製品」、「高集積分野向け製品」、「ディスプレイ向け製品」、「その他」の5つのテーマを中心に新しい時代を切り拓く最先端技術の発展に貢献する各種製品を展示します。第20回JPCA賞（アワード）を受賞した、「パワー半導体向け高放熱絶縁材料」をはじめ、PCB用高機能性ソルダーレジスト（以下、SR）、パッケージ基板用高信頼性SR、各種層間絶縁材料、各種穴埋め材料、ギャップ埋め材料、放熱材料、半導体封止材料、感光性カバーレイ、立体成型基板用材料、ディスプレイ向け各種材料等をご紹介します。また、立体成型基板用材料は、MIDパビリオンにも出展します。

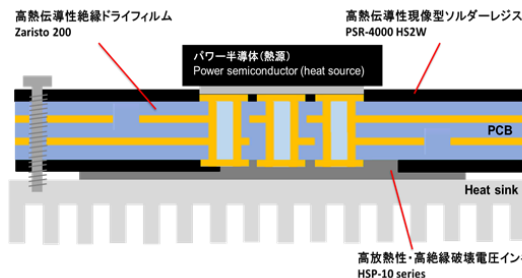


【第20回JPCA賞（アワード）受賞製品について】※太陽インキ製造は今回で5年連続のJPCA賞（アワード）の受賞です。

製品名：「パワー半導体向け高放熱絶縁材料」

製品概要：高い絶縁信頼性と熱伝導性を両立させた、パワー半導体搭載基板に好適な各種絶縁材料

開発経緯：電子機器において、小型化・高性能化が求められる一方で「省エネルギー化」が大きな課題となっています。このような状況の中、電力損失の少ないパワー半導体が注目を集めていますが、効率化や小型化が進むにつれて「熱対策」という新たな課題への対応が必要になっています。今回開発した「高放熱材料」は、この「熱対策」に貢献します。



### ■「JPCA Show 2024」開催概要

開催期間：2024年6月12日（水）～14日（金）

会場：東京ビッグサイト 東5ホール

ブース番号：5F-47（MIDパビリオン：3B-47）

展示会詳細：<https://www.jpca2024.com/show2024/index.html>

当社出展概要：<https://unifiedsearch.jcpcbmatch.jp/jpca2024/jp/jpca/details/RqIZCG3cs4w>

\*ブースにお越しいただいた方には、限定グッズを先着で700名様に贈呈いたします。